# 2025년「지능형반도체 개발·실증 지원」사업 애로기술 컨설팅 지원 모집 2차 공고

한국팹리스산업협회에서는 산업통상자원부가 지원하는 「지능형반도체 개발·실증 지원」 사업의 일환으로, 국내 지능형반도체 기업의 경쟁력 강화를 위한 **애로기술 컨설팅 지원** 프로그램을 다음과 같이 2차 공고하오니. 관심 있는 기업의 많은 참여를 부탁 드립니다.

> 2025년 4월 4일 한국팹리스산업협회장

## 1 사업개요

#### 가. 사 업 명

○ 「지능형 반도체 개발·실증 지원」 애로기술 컨설팅 지원

### 나. 사업목적

비수도권 지능형 반도체 기업의 제품 개발 및 검증 과정에서 발생하는 애로기술 해결지원을 통한 중소·중견 기업의 연구개발 활성화 및 자체 기술력 확보

## 2 지원내용

### 가. 지원대상

○ 비수도권(서울·경기·해외 제외) 소재 지능형 반도체 기업(팹리스, IP 전문 기업 등)으로 중소기업 및 중견기업

### 나. 지원범위

○ 지능형 반도체 개발(설계 및 검증, 제품화 후속 개발 등) 전단계에서

발생하는 애로기술에 대한 컨설팅 비용 지원

#### 다. 지원내용

- 지원 규모: 기업당 최대 5백만원 (최대 3개 사, 부가가치세 제외)
- 사업 기간 : 협약 체결일로부터 3개월
- 지원 방식 : 간접지원 (컨설팅 업체에 지원금 지급)
  - ※ 컨설팅(계약 등) 시작 기간이 공고일 이후 진행되는 건에 한함
  - ※ 지원 규모(기업당 최대 5백만원)를 초과하는 비용은 기업 부담

## 3 지원자격 및 우대사항

#### 가. 지원자격

- ① 지능형 반도체 설계 기업(팹리스, IP 전문 기업 등)으로 중소기업\* 및 중견기업\*\*이며, 다음 요건 중 하나라도 해당하는 기업
  - (1) 비수도권(서울·경기·해외 제외) 내 본사, 지사, 공장, 연구소 중 1개 이상 소재한 기업
  - (2) '26년까지 (대구)지능형반도체개발지원센터 입주 예정\*\*\*인 기업
- ② 본 지원프로그램의 목적 및 취지에 부합하는 국내 지능형 반도체 기업
- \* 중소기업기본법 제2조 및 중소기업시행령 제3조(중소기업의 범위)에 해당하는 중소기업
- \*\* 중견기업성장촉진 및 경쟁력강화에 관한 특별법 제2조에 해당하는 중견기업
- \*\*\* 컨설팅(계약 등) 시작 기간이 공고일 이후 진행되는 건에 한함

### 나. 우대사항

- 지능형반도체개발지원센터 입주 및 '26년까지 입주예정인 기업
- 「지능형반도체 개발·실증 지원」사업의 시제품제작지원 사업과 동일한 제품 및 과제로 연계하여 지원하는 기업
- 대구·경북지역 기업(사업자등록증 소재지 기준)

## 4 평가안내

### 가. 평가절차 및 일정

공고/모집		평가/선정		협약체결		결과평가		사업비지급
신청서 접수	>	<b>선정평가</b> (서면)	>	<b>협약</b> (협회-기업)	>	최종 결과 <b>평</b> 가	>	기업지원금 신청 및 지급

※ 상기 평가일정 등은 추진상황에 따라 변경될 수 있음

#### 나. 평가방법

- 서류검토
  - 결격사유 및 신청자격 적합성 여부 판단
- 선정평가
  - 평가계획에 의거하여 서면평가로 진행
  - 산·학·연 전문가 5인 내외로 구성된 평가위원회를 통해 선정
  - 평가항목에 따라 신청기업에서 제출한 지원 신청서류 평가
  - 선정평가 통과 기업에 대해 선정결과 개별 안내
  - 중요한 판단 이슈 발생 시 책임자 또는 실무자와의 전화 인터뷰 추진

### 다. 평가항목

평가 지표(배점)	평가 항목				
	신청서 오류 및 성실 작성 여부				
신청자격 적합성 (15)	제출 서류의 누락 및 부실 여부				
	지원 및 제외 대상 해당 여부				
컨설팅 계획 적절성	애로기술 해결 목표와 컨설팅 수행 계획의 명확성 및 구체성				
(30)	컨설팅 결과 활용 계획의 우수성 및 구체성				
사업비 사용계획 적절성 (25)	사업비 편성 및 산출의 적절성				
성공적 결과 도출 가능성	고품질의 컨설팅 결과물 도출 가능성				
(30)	기대성과의 달성 가능성				

평가 지표(배점)	평가 항목
	지능형반도체개발지원센터 입주 및 '26년까지 입주예정 기업
우대사항 (10)	'지능형반도체 개발·실증 지원'사업의 시제품제작지원 사업과 동일한 제품 및 과제로 연계하여 지원하는 기업
	대구ㆍ경북지역 기업

<sup>\*</sup>우대사항은 최대 10점으로, 여러 항목에 해당하는 경우 최고점 적용(10점)

- 평가위원의 신청기업별 총점으로 종합평가점수 산정
- 평가표의 최고점과 최저점을 제외한 산술평균이 70점 이상인 경우 선정
- 평가위원의 절대평가 후 종합평점에 따른 고득점 순으로 선정 하되, 우대가점 포함 70점 미만인 경우 탈락
- 동점일 경우, 높은 배점의 항목 점수가 높은 순으로 선정
- 최종 결과는 개별 통보하며, 평가결과에 대해서는 원칙적으로 공개 하지 않음

## 5 신청방법

## 가. 제출서류

번 호	서 류 명	부 수	제 출	비고	형 태
1	지원신청서			지정서식	HWP
2	지원신청서(날인본)			(*관련 견적서 포함 제출)	
3	최근 2개년도 재무제표		ᆔ		
4	사업자등록증 사본		필수		
5	국세 · 지방세 완납증명서			-	
6	법인인감증명서	1부			PDF
	지능형반도체개발지원센터 입주계약서(또는 입주예정서)			-	151
7	대구ㆍ경북 소재지 입증 서류		해당시	사업자 등록증 등	
	협회 사업 참여 입증 서류			협약서 등	

### 나. 신청안내

- 한국팹리스산업협회 홈페이지(www.k-fabless.com)에서 공고문 확인
- 신청기간 : 2025년 4월 4일(금) ~ 상시모집
  - ※ 최대 3개 사 선정 완료 시 접수 종료
- 제 출 처 : kfia.kty@gmail.com

#### 다. 작성요령

- 신청서의 성실한 작성도 평가항목이므로 예시 및 작성요령에서 제시한 사항을 참고하여 성의있게 작성
- 제출서류가 위·변조 혹은 허위임이 밝혀질 경우 그 즉시 선정 취소 또는 협약이 해약되므로 사실대로 작성하여 제출
- 서류제출 시 파일명에 순번과 서류명, 신청기업명 기입 (ex. 3\_사업자등록증\_(주)팹리스기업)

## 6 유의사항

#### 가. 지원제외 처리기준

- 타 정부과제 중복지원 불가 (동일 건으로 중복지원 불가)
- 신청기업이 지원사업의 목표, 취지에 부합하지 않는 경우(외국계 기업의 국내법인 등)
- 접수마감일 현재 신청기업이 국가연구개발사업에 참여 제한을받고 있는 경우
- 접수마감일 현재 신청기업이 아래의 어느 하나에 해당하는 경우
  - 기업의 부도
  - 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우(단, 희생인가 받은 기업, 중소벤처기업진흥공단 등으로부터 재창업 자금을 지원받은 기업은 예외)
- 접수기간 내 사업계획서 등의 서류 제출이 미비한 경우

# 7 문의처

- 담당자 : 김태연 PM
- 한국팹리스산업협회 (031-706-9777, kfia.kty@gmail.com)
- 지능형반도체개발지원센터 (070-7854-6211)

### 붙임.

## '지능형 반도체 개발·실증 지원'사업 지원 프로그램 안내

\* '지능형 반도체 개발지원센터'에서는 제품 개발 주기별 지원 프로그램을 운영 중이며, 제품 개발을 위해 동일한 제품 및 과제로 연계하여 다른 프로 그램에 지원신청 가능함.

제품기획	>>	반도체 설계	(>)	제조(FAB)	(S)	패키징	»	제품화개발	»	시장 진출
		애로기술지원		시제	품 제작자	원		애로기술지원		전시회 참가지원
	100							시험분석지원		
							R	품화 개발 실증 지	원	

#### o 지원프로그램 안내

구분	지원프로그램	지원 내용	비고		
	시제품 제작지원	- MPW 제작, FPGA제작, 디자인하우스 비용 - 기업당 최대 4천만원	한국팹리스산업협회 * 문의:		
	애로기술 컨설팅 지원	- 지능형 반도체 개발(설계, 검증, 제품화 후속 개발 포함) 전단계 애로기술 컨설팅 비용 - 기업당 최대 5백만원	(시제품) kfia.pso@gmail.com (컨설팅) kfia.kty@gmail.com		
개발 및 제품화	시험분석 및 성능검증 지원	- 팹리스 기업이 개발한 지능형 반도체 및 모듈, 보드, 제품의 시험분석 및 성능 검증(인증) 비용	경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원 * 문의 : kch@iact.or.kr		
지원	제품 검사지원	- 비파괴검사장비(3D CT)를 이용한 칩 패키지, 모듈, 기판, 제품 등의 검사, 분석, 계측장비 활용지원			
	상용화 지원 (모듈/보드/제품 개발 및 실증)	<ul> <li>수요처와 연계한 제품화 개발,</li> <li>테스트 및 실증 지원</li> <li>지원대상 : 후속 제품화 개발과 실증이 필요한 지능형 반도체 적용 모듈,</li> <li>기능성 보드 및 제품</li> </ul>			
생태계 활성화 지원	전시회 참가지원	- 국내외 전시회 비용(부스임차 및 참가비, 독립부스 구축비, 제반시설 및 장치비			

\* 각 지원 프로그램별 세부내용은 개별공고에 따라 변동될 수 있으므로, 담당자에게 문의 혹은 게시되는 공고문 반드시 확인필요.